

スパッタリング装置 SP-3600



本装置は4インチ3源スパッタ装置で、膜厚分布を良くするために各カソードのマグネットが回転する構造になっております。

基板ヒーターはマイクロセラミックヒーターを採用しておりますので、350℃迄短時間で昇温します。

大きなオペレートタッチ画面と、初心者でも簡単に操作可能な排気系の自動操作、誤動作防止のための安全回路を搭載。ターボ分子ポンプによるクリーンな排気において、金属膜、酸化膜、絶縁膜の良質な成膜が可能です。

又、最大の特徴はRFスパッタ成膜を最大3源、自動成膜が可能で、逆スパッタも自動運転可能です。

スパッタリング装置SP-3600仕様

○到達圧力	7.0×10 ⁻⁵ Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ600mm×400mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 600W 自動マッチング 1台
○逆スパッタ機構	有り
○基板形状	φ4インチ×3枚
○膜厚分布	±10%以内
○ターゲット寸法	4インチ(金属・酸化物・絶縁物)
○ターゲット個数	3
○基板回転	有り
○TS間距離	50～150mmの間にて可変可能
○基板加熱	常温～350℃迄昇温可能
○真空排気系	制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計 油回転ポンプ:400L/min(60Hz) ターボ分子ポンプ:480L/sec
○操作方法	自動/手動選択可能
○ガス系統	マスフローコントローラ 2系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相 10.0kVA 冷却水:10L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上
	寸法: 装置架台本体:1244mmW×1002mmD×(1996)mmH 制御盤:570mmW×1000mmD×(1859)mmH